

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-22

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>券商策略会</u> ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	中庚基金、朱雀基金、太平基金、广发基金、华安基金、中银基金、恒越基金、中信建投证券、鑫元投资、星石投资、易方达基金、上海彤源发展、诺德基金、兴银理财、国华人寿、海富通基金、西部利得基金、兴业证券、天风证券资管、上海东方证券、上海松熙私募、上海陆宝投资、上海勤辰私募、上海合远私募、拾贝投资、上海明河投资、上海贤盛投资、天治基金、国信证券、方正证券
时间	2024年5月8日
地点	方正证券策略会举办地（上海）、国信证券策略会举办地（上海）
上市公司接待人员姓名	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司2024年一季度PCB业务各下游领域经营拓展情况。</p> <p>2024年一季度，公司PCB业务通信领域无线侧订单需求较去年第四季度未出现明显改善，有线侧交换机、光模块等需求有所增长。数据中心领域订单需求环比继续增长，主要得益于Eagle Stream平台产品逐步起量，叠加AI加速卡等产品需求增长。汽车电子领域继续把握在新能源和ADAS方向的机会，延续往期需求。工控医疗等领域业务占比相对较小且需求相对保持平稳。</p> <p>Q2、请介绍当前AI领域的发展对公司PCB业务产生的影响。</p> <p>伴随AI的加速演进和应用上的不断深化，ICT产业对于高算力和高速网络的需求日益紧迫，各类终端应用对边缘计算能力和数据高速交换与传输的需求迎来增长。上述趋势驱动了终端电子设备对高频高速、集成化、小型化、轻薄化、高散热等相关PCB产品需求的提升。公司PCB业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI加速卡、存储器</p>

等领域的 PCB 产品需求将受到上述趋势的影响。

Q3、请介绍公司 PCB 各工厂是否区分不同下游领域安排生产。

公司在深圳、无锡、南通拥有多个 PCB 工厂。除部分专业工厂外，公司主要根据不同 PCB 产品的工艺要求特征来安排生产，产线本身对工艺相似的不同下游领域产品具有一定兼容性。

Q4、请介绍公司 PCB 业务 HDI 工艺能力及相关产品布局情况。

HDI 作为一项平台型工艺技术，能够实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备包括 Any Layer（任意层互联）在内的 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。

Q5、请介绍公司 2024 年一季度封装基板业务经营拓展情况。

2024 年一季度，公司封装基板业务需求整体延续去年第四季度态势。BT 类封装基板保持稳定批量生产，FC-BGA 封装基板各阶产品对应的产线验证导入、送样认证等工作有序推进。

Q6、请介绍公司封装基板业务主要产品类型。

公司生产的封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。公司目前已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺，建立了适应集成电路领域的运营体系，具备了包括 WB、FC 封装形式全覆盖的 BT 类封装基板量产能力，并持续推进 FC-BGA 产品在广州封装基板项目的平台能力建设。

Q7、请介绍公司目前工厂整体稼动率情况。

近期公司 PCB 及封装基板业务稼动率较 2023 年第四季度均有所提升。

Q8、请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。

公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂，总投资额

	<p>为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前已办理完成泰国子公司的备案登记事宜，并先后收到国家发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》、国家商务部颁发的《企业境外投资证书》。签订土地购买协议，出资 2.89 亿泰铢购买约 70 莱的洛加纳工业园区内工业用地，并已筹备开展各项建设工作，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。</p> <p>Q9、请介绍上游原材料价格变化情况及对公司的影响。</p> <p>公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，就公司成本端而言，2023 年至 2024 年一季度原材料价格整体相对保持稳定。近期受大宗商品价格变化影响，贵金属等部分辅材价格有所上升，部分板材价格亦有抬头趋势，目前暂未对公司经营产生直接影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 8 日